

2.5D TSV Interposer

2.5D TSV Interposer

MicroBump
TSV

Interposer

C4Bump

Memory etc.

Processor

Package

トップダイは並ぶため実装面積は大きくなる

トップダイは並ぶために排熱は容易となる

トップダイのプロセッサなどにはTSVが不要であるため、コストを抑えられる

チップ間を広帯域&低電力に接続できるが、ダイレクト接続よりも制限される

トップダイへは、信号や電力がインタポーザのTSVを経由するため抵抗と信号品質で不利に

インタポーザは、トップダイを全て載せることができる面積とTSVが必要となり、コストがかかる